

Überbrückung der Lücke zwischen OSP und metallischer Endoberfläche

PRODUCT
Image
Unavailable

PRODUCT
Image
Unavailable

Das richtige Verhältnis zwischen Kosten und Performance zu finden, ist in allen Bereichen der Leiterplattenlieferkette ein Balanceakt. Der letzte Verfahrensschritt, der nur einen Bruchteil von einem Prozent der gesamten Leiterplattenkosten ausmacht, ist der Verfahrensschritt, der wahrscheinlich die größte Auswirkung auf die Fertigung hat. Dieser Schritt, die Endoberfläche, wirkt sich erheblich auf die Haltbarkeit, die Lötbarkeit, die In-Circuit-Testfähigkeit sowie auf die Festigkeit der Lötverbindung und die Zuverlässigkeit aus. Bisher gab es nur zwei Optionen bei Leiterplatten- Endoberflächen: organisch oder metallisch. Der organische Oberflächenschutz (OSP) berücksichtigt die meisten Bestückungsanforderungen zu den geringsten Kosten. Metallische Endoberflächen berücksichtigen zwar einen größeren Bereich der Bestückung, aber zu Kosten, die die OSP-Kosten um ein Vielfaches übersteigen. Enthone hat Entek OM entwickelt – eine neue Klasse von Leiterplattenendoberflächen.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Preis inkl. Preisnachlass: 2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)